

证券代码：688469

证券简称：芯联集成

公告编号：2026-010

芯联集成电路制造股份有限公司 关于2026年度银行授信额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称“公司”）及公司子公司2026年度拟向国有银行、商业银行、融资租赁公司或政策性银行申请总额不超过人民币200亿元的综合授信额度（最终以各银行及其他金融机构实际核准的信用额度为准）。

● 本次银行授信事项已经公司第二届董事会第十三次会议审议，尚需提交公司股东会审议。

公司于2026年4月17日召开了第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及公司子公司在2026年度向国有银行、商业银行、融资租赁公司或政策性银行申请总额不超过人民币200亿元的综合授信额度（最终以各银行及其他金融机构实际核准的信用额度为准）。具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准，并授权总经理在上述授信额度范围内及董事会议案范围内行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

以上授权的有效期为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。在授信期限内，授信额度可循环使用。授信额度不等于公司的实

际融资金额，具体金额以公司及公司子公司与金融机构实际发生的融资金额为准，实际融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求决定。

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司董事会

2026年4月21日